

第 55 回

地盤工学研究発表会

技術展示コーナー募集案内

会期：2020年7月21日(火)～7月23日(木)

会場：国立京都国際会館（京都市）

公益社団法人 地盤工学会

ご挨拶

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は地盤工学会の活動に格別のご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、地盤工学会では、2020年7月21日(火)～7月23日(木)に京都府京都市において第55回地盤工学研究発表会を開催します。約2,000人の関係者が全国から参加し、地盤工学に関する最新の研究、技術の発表が行われます。

地盤工学分野では、新しい施工法、材料、調査法、試験法、設計法、解析法、防災・環境保全など優れた技術が各機関・各企業で開発されています。その一部は、今回の研究発表会で発表されますが、さらに深く紹介する場も必要かと存じます。そのため、各機関・各企業の優れた技術を紹介していただく場所として、「技術展示コーナー」を企画いたしました。これによって各機関・各企業はもちろんのこと、学会員同士の活発な情報交換が期待できるだけでなく、一般市民や学生を含めた方々にご来場いただくことで、地盤工学会を広く知っていただく非常に良い機会になることが期待されます。

つきましては、貴機関・貴企業におかれましては、来る第55回地盤工学研究発表会(京都大会)の「技術展示コーナー」に出展していただきたく、ご案内申し上げます。「募集要項」をご覧ください。是非ともご出展いただきますようお願い申し上げます。なお、同会場展示会場では技術展示コーナーに併設して各種イベントを開催し、大勢の方々に技術展示コーナーへ足をお運びいただけるような工夫を図りたいと考えております。

敬具

公益社団法人 地盤工学会

第55回地盤工学研究発表会実行委員会

実行委員長 **三村 衛**

技術展示コーナー 募集要項

1. 開催要旨

第 55 回地盤工学研究発表会における研究発表に加えて、各機関・各企業の優れた技術を紹介する場として、「技術展示コーナー」を企画します。

会員だけでなく一般・学生の皆様にも広く参加を呼びかけ、技術展示コーナーに多くの方々に来場していただき、地盤工学を知っていただく機会づくりを目指します。またこれを促進するために、技術展示コーナーでは、期間中、各種企画を計画しております。是非ご応募ください。

2. 出展期間

2020年7月21日(火) 9:00~18:00

7月22日(水) 9:00~16:30

7月23日(木) 9:00~15:00

■搬入設営：7月20日(月) 予定

■搬出撤去：7月23日(木) 15:00~

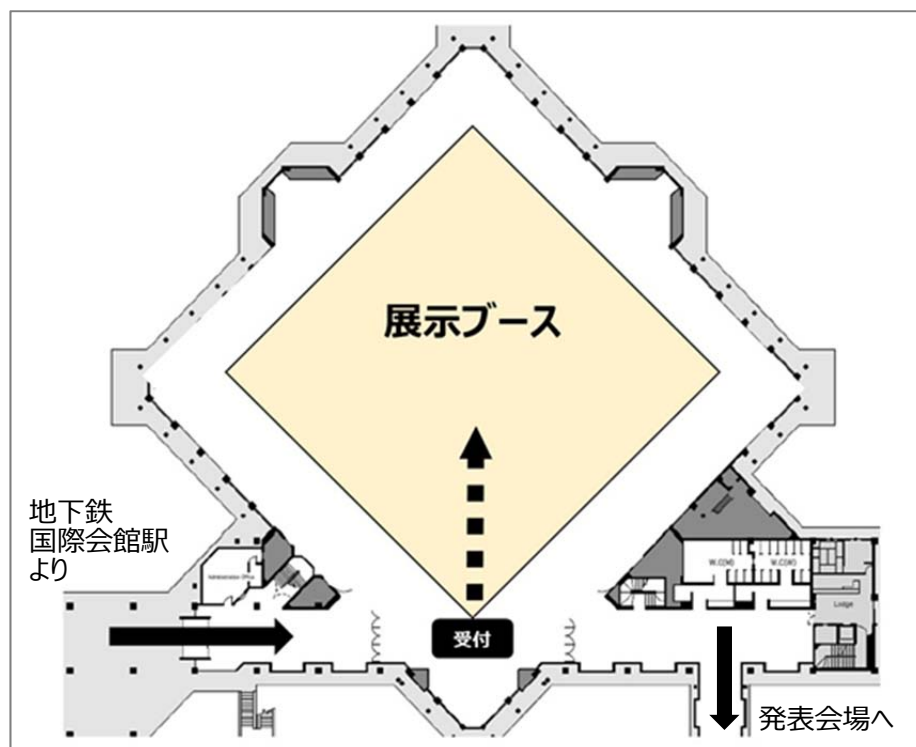
※上記の時間帯は研究発表会のプログラム等に応じて変更する場合があります。

3. 会場

国立京都国際会館「イベントホール」 ※下図参照

(〒606-0001 京都府京都市左京区岩倉大鷲町 422)

■イベントホール



4. 出展料金

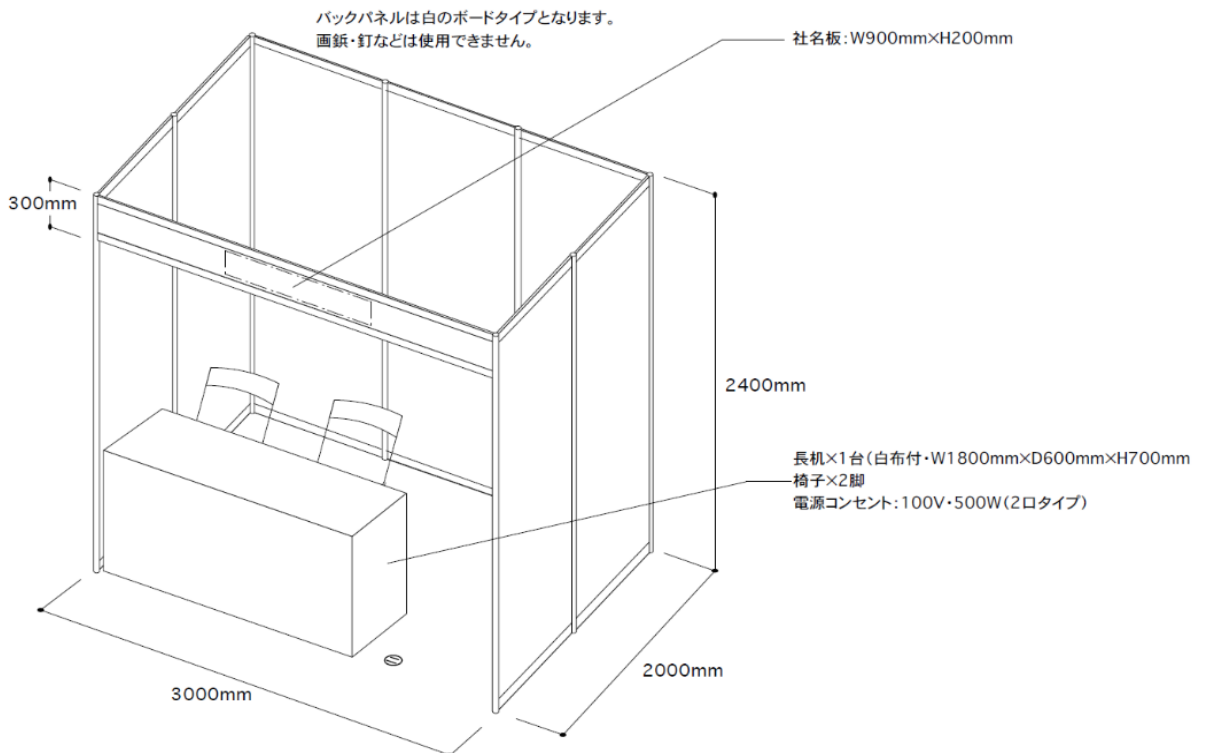
1ブース：300,000円（税込） 2ブース：500,000円（税込）

※3ブース以上の場合は、お問い合わせください。

5. 基礎小間仕様

サイズ：幅(間口) 3,000×奥行 2,000×高さ 2,400 mm（バックパネル・サイドパネル含む。）

標準備品：長机（白布付）1台・椅子2脚・社名板・蛍光灯1台・電源100V/500W



6. 出展特典

出展者には、以下の特典がございます。

- ・発表概要集へのアクセス権
- ・3名様分の発表会参加証（参加証をお持ちの方は、研究発表会にご参加頂けます）
- ・その他、魅力ある特典を随時追加致します

7. オプション備品レンタル

オプションとして各種備品のレンタルもご利用いただけます。詳細につきましては、下記展示事務局までお問い合わせください。

8. 申込方法

別紙出展申込書にご記入のうえ、E-mail もしくは FAX にて展示事務局までお送りください。
お申し込み受付後、出展方法やお支払い方法などの詳細を別途ご連絡いたします。

*** 申込締切日 2020年1月31日(金)**

なお、ブース数には限りがあるため、上記期日前であっても状況に応じてお申込みを締め切る場合があります。ご出展をご希望される場合は、お早目にお申込みを頂きたいお願い申し上げます。

9. 出展場所

出展者のブース位置は主催者で決定しますが、特別会員を優先的に配置する予定です。

特別会員の入会方法については、地盤工学会 HP をご確認ください。

https://www.jiban.or.jp/?page_id=876

10. その他併設コーナーについて

その他併設コーナーとして、特別会員 PR、実機展示、ドリンク・休憩・談話スペース等も設置予定としております。詳細は別途お知らせいたします。

11. お問い合わせ先

第55回地盤工学研究発表会（京都大会） 展示事務局
株式会社フジヤ 京都大会担当：石崎 悦朗

【住所】〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 国立京都国際会館内

【TEL】(075)705-1258 【FAX】(075)712-1333

【E-mail】e-ishizaki@fujiya-net.co.jp

FAX (075)712-1333

申込締切日 2020年 1月31日 (金)

第 55 回地盤工学研究発表会 展示事務局 行

第 55 回地盤工学研究発表会 技術展示コーナー出展申込書

申込日 年 月 日

- 貴 社 名 : _____
- ご担当部署名 : _____
- ご 担 当 者 名 : _____
- 住 所 : _____
- 電話・FAX : 電話 _____ FAX _____
- メールアドレス : _____ @ _____

※ご記入いただいた個人情報に関しては、本研究発表会ならびに地盤工学会のご案内以外には使用いたしません。

●お申込内容 (3ブース以上の場合は、お問い合わせください。)

- 1ブース 300,000円 (税込) 2ブース 500,000円 (税込)

●ご要望事項 (ご出展につきましてご要望などございましたら、下記にご記入ください。)

●出展料金のご請求先

上記ご連絡先と異なる場合は、下記にご住所、ご担当部署などをご記入ください。